

Les puces 3D flash d'Intel et Micron ouvrent la voie aux SSD grande capacité

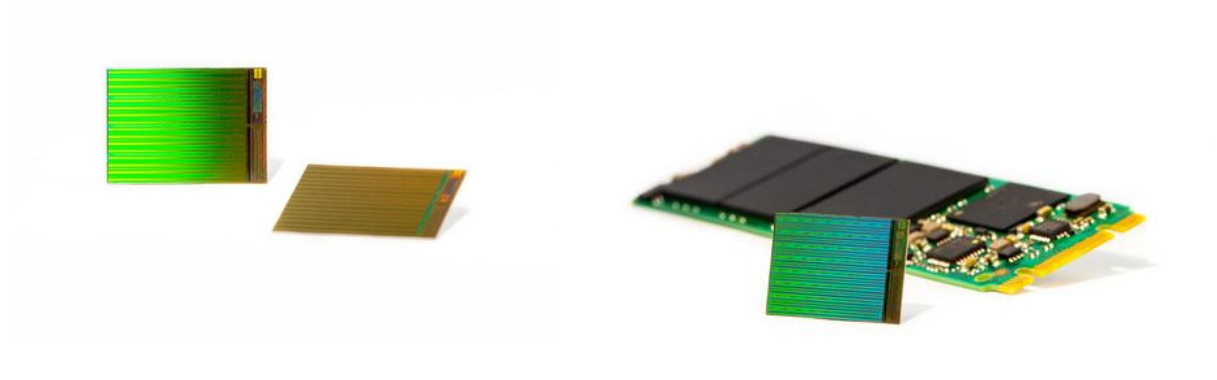
Grâce aux composants 3D NAND flash d'Intel et Micron qui permettent d'empiler davantage de bits dans un espace plus petit, les smartphones, tablettes et PC pourront bientôt bénéficier de capacités de stockage en hausse.

Les puces 3D NAND nous rapprochent des disques SSD de plus de 10 To ». Que ce soit dans les tablettes haut de gamme ou dans les ordinateurs portables légers, les puces à mémoire flash pourront être combinées à des SSD de plus de 3,5 To dont la taille ne dépassera pas celle d'une gomme à effacer.

Ces composants permettront également aux fabricants de doubler ou de tripler les capacités de stockage des smartphones - elle plafonne actuellement à 128 Go - sans augmenter leur prix.

Les puces à mémoire flash devraient également augmenter les performances et la fiabilité des smartphones, PC et serveurs, les SSD sont à la fois plus rapides et consomment moins d'énergie que les disques durs classiques, mais leur capacité était encore bloquée entre 3,2 et 4 To.

Micron, qui vend des lecteurs flash, commencera à commercialiser des SSD de grande capacité basée sur ces puces à partir du second semestre de cette année. Et Intel compte proposer au grand public et aux entreprises des SSD basés sur cette technologie dans un délai qui reste à préciser.



Une cellule 3D NAND fabriquée dans l'usine Intel/Micron

&

Cette carte flash au format M2 accueille des composants 3D NAND

